证券代码：603986 证券简称：兆易创新

**兆易创新科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2023-003

|  |  |
| --- | --- |
| **调研日期：**2023年10月30日 | **调研时间**：20:00-20:45 |
| **调研地点:**电话会议 |
| **接待人姓名及职务：**副董事长、总经理何卫，董事、副总经理胡洪，副总经理李宝魁，副总经理、董事会秘书李晓燕，副总经理、财务负责人孙桂静 |
| **来访人员**长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、晨壹投资有限公司、北京逸原达投资管理有限公司、上海国际信托有限公司、华富基金管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、首创证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、朱雀基金管理有限公司、安信证券资产管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、东海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、广东睿璞投资管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、厦门中略投资管理有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司、上海君和立成投资管理中心(有限合伙)、深圳鑫然投资管理有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、上海石锋资产管理有限公司、中邮证券有限责任公司、上海敦颐资产管理有限公司、摩根士丹利证券(中国)有限公司、立格资本投资有限公司、中信里昂证券有限公司、世纪证券有限责任公司、国融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、华安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、天隼投资管理咨询(上海)有限公司、长安基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、上海京笙投资管理有限公司、华夏未来资本管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)、国新证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、美银证券、摩根大通证券(中国)有限公司、深圳市宏盛天资产管理有限公司、华泰证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、摩根大通集团、浙江四叶草资产管理有限公司、摩根士丹利投资管理公司、信达证券股份有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、国泰君安证券股份有限公司、新加坡政府投资公司GIC、浙商证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、上海原泽私募基金管理有限公司、上海沣杨资产管理有限公司、中信保诚资产管理有限责任公司等约346方。 |

|  |
| --- |
| 调研活动主要内容：**问题1、存储板块第四季度及明年景气度的展望？** 回答：存储分为大存储和利基存储两大块。大存储包括用于手机、PC和服务器的DRAM以及3D Nand，主要供应商为以三星为代表的国际头部厂商。大存储经历了约6-7个季度的下跌周期，在今年第三季度我们认为已经达到了价格的底部区间，随着主要厂商的持续减产，达到了供需基本平衡的状态。在今年三季度末大存储出现一些价格反弹，此反弹对利基存储有一定的带动效应，利基存储价格也在筑底并有微弱反弹。明年我们认为大体上随着减产效应的体现，供需会达到平衡的状态，大存储的价格有望延续反弹的走势，但也不太会出现暴涨暴跌的情况；利基型DRAM也会随着大存储反弹的走势，延续微弱反弹的趋势。具体供需关系还要看明年需求的恢复情况以及主流厂商减产的持续时间。在NOR Flash和SLC Nand Flash,其应用场景非常广泛，随着客户以及渠道库存的去化，以及消费类的恢复，产品需求量和消费量有所反弹。从公司的经营情况看，NOR Flash出货总容量呈现逐季增长的趋势；从行业和行业友商的情况来看，明年的需求会保持一个比较正常的状态，各家的库存情况应该会得到有效的去化，我们预计会逐渐恢复到供需平衡的状态；从价格来看，NOR Flash和SLC Nand Flash过去几个季度还是延续下跌的趋势，近期看基本上跌幅在不断缩小，已经趋于平稳，我们也会密切关注市场走势和价格变动情况。**问题2、公司毛利率后续是否会持续改善？**回答：三季度毛利率提升主要有两个原因：一是随着公司经营策略的演进，经销DRAM业务大幅缩减。经销DRAM业务毛利率非常低，此业务的大幅缩减对公司整体毛利率提升有帮助；二是三季度有一部分之前计提存货减值的产品实现销售，利润冲回。从主要产品看，NOR Flash和MCU在三季度并没有明显的毛利率提升，产品平均价格还处于底部的区间。DRAM价格有微弱反弹，NOR Flash和MCU价格目前还在筑底过程中，我们认为需求和价格基本已到底部，但价格真正有效的反弹还要再持续观察。第四季度是传统的淡季，供需和价格会趋于平稳，明年毛利率的情况主要还是要看明年需求回暖的情况。**问题3、公司DRAM业务的整体规划？**回答：公司DRAM业务基于和核心供应商的战略合作关系，在供应链上有保障。公司DRAM主要为利基型产品，即非应用于手机、PC、服务器的DRAM产品，包括小容量DDR4及LPDDR4、DDR3等产品。过去几年公司DRAM业务处于从无到有开展技术研发的过程，经过努力DDR4实现量产，DDR3在2023年基本完成功能验证和客户导入的工作，目前处于良率提升和起量爬坡阶段，有望在2024年为公司贡献更多营收。公司也在积极开展8Gb DDR4等其他利基型DRAM产品研发，希望补齐整个标准接口利基型DRAM产品线，有效支撑公司DRAM业务发展，满足客户需求。**问题4、MCU产品价格趋势？**回答：MCU产品价格已经经历了大约4个季度的下降，到今年第三季度价格基本趋于平稳，第四季度价格仍会是趋于平稳并筑底的阶段。**问题5、M7内核新产品目前的进展情况？**回答：M7内核MCU产品有多个系列，很多客户在做导入，10月份开始陆续进入量产，已经有部分型号产品量产交付，其他型号产品也会陆续进入量产阶段，整体看还是比较顺利。 **问题6、目前MCU行业竞争激烈，公司对行业竞争格局的展望？**回答：前两年MCU缺货，很多厂商进入MCU领域，市场竞争非常激烈。从公司多年MCU业务发展来看，MCU产品比较有门槛，主要表现是MCU客户群体非常分散，公司MCU客户有2万多家，由非常多的客户才取得目前的规模，因此MCU产品形成较好体量难度比较大。今年行业整体下行的情况下，更加速了行业的洗牌，现在是一个非常艰难的内卷时期，但是随着行业的洗牌，未来会越来越好。**问题7、公司目前存货情况？**回答：近几个季度以来公司存货呈逐步下降的趋势，公司也在加大去库存的力度。在产成品和半成品上，每个BU的情况不一样，生产周期也不一样，有的BU产成品多一些，有的BU原材料库存多一些。公司存货的整体周转情况与销售状况基本匹配，目前存货周转率大约是5-6个月。在存货账龄上，现在是一年以内的存货居多，一年以上的存货是少数。对于长账龄存货，包括即使是在一年以内的存货，我们也会考虑未来的销售情况计提相应减值，目前存货减值计提充分。**问题8、晶圆和封测端成本的下降预计在什么时候会对公司毛利率提升有大幅明显的体现？预计四季度毛利率通过成本优化带来的提升空间如何？**回答：公司存货流转状况是按先进先出的原则，即先前高价库存先出、后续低价库存后出。在会计核算上则是按照加权平均计算，所以成本变化的幅度不一定和代工采购成本的变化完全相符，在成本端的体现会是一个平滑的过程。成本端变化带来的毛利率变化，在不同BU也会有区别，因为不同BU的产品在其生产的晶圆厂代工价格有区别。 **问题9、存储周期上行的情况下，明年存储产品价格上涨的弹性如何？** 回答：利基DRAM价格受主流DRAM价格的牵引，主流DRAM价格如果出现大幅反弹，会带动利基DRAM的价格反弹。展望明年，主要还是看行业头部供应商的产能策略和价格策略。NOR Flash产品上，我们判断现在供应较充足，主要供应商的产能都在正常状态，整体产能在过去两年的基础上还有增长，如果市场需求在延续现有态势上微弱反弹，目前产能还是可以满足需求。在此情况下，我们判断NOR Flash价格在下一轮供需平衡达成以前，不会出现明显的上涨。需要在下一轮供需平衡达成并维持一段时间以后，观察是否有新的需求牵引，带动价格上涨。同时如果有部分供应商退出，也会减少整体的供应量，也可能推动价格上涨。公司仍延续既有战略，以产品研发和市占率为主。**问题10、公司DRAM产品代工厂商产能情况？** 回答：公司为Fabless模式，所有的晶圆生产都由供应商伙伴来完成，包括利基DRAM。目前公司利基DRAM产能正常。**问题11、公司RISC-V架构产品情况？**回答：2019年公司即推出了RISC-V架构的MCU产品，今年10月公司新发布RISC-V架构双模无线MCU产品，未来还会有更多的产品发布。ARM内核产品最大优势在于生态非常完备，RISC-V架构优势在于成本更好，需要RISC-V架构产品的客户通常对成本比较敏感，同时自身研发实力较强。公司会跟随市场需求做技术准备并开发产品线。**问题12、公司车规MCU是否会有更多新产品发布？**回答：会有新产品发布。公司车规MCU从车身域做起，逐渐会做到更高需求、更高功能安全等级的领域，包括底盘、动力域等。**问题13、公司半年报中库存是原材料增加比较多，产成品下降比较多，三季度是否相同？原材料增加比较多的原因？**回答：三季度的趋势和二季度基本一致。从整体销售额看，Flash产品占比较大，存货占比亦相应较高，存货中大部分在原材料阶段\测试阶段，并在生产周期允许的范围内去生产。相比前端生产周期，封装周期较短，一旦有市场需求，即可快速完成封装形成产成品满足客户需求，因此公司存货中原材料会多一些。**问题14、后续晶圆价格下降，在售价维持稳定、成本下降的情况下，四季度毛利率是否是上升的趋势？**回答：在成本端不会很快有大幅度的下降，因为产品生产周期较长，通常晶圆生产阶段约3-4个月，封测阶段约1-2个月，目前的产品会是至少在半年之前的订单生产的产品。在此情况下，成本下降会是一个较慢一些的过程，带来的毛利率提升也不会是一个快速的提升。同时四季度毛利率还需要观察供需和产品售价的变化情况。**问题15、利基DRAM价格受主流DRAM价格的牵引，主流DRAM涨价会带动利基DRAM涨价，从过往周期来看，这个过程需要多长时间？**回答：利基DRAM价格和主流DRAM价格有趋同性，因为行业头部的供应商既是主流DRAM的供应商，也是利基DRAM的主要供应商，但此价格的联动性也并无一定之规。具体到每一款产品，还是根据供求关系来决定，前年也出现过DDR3某些款的产品，其价格涨幅比标准型DRAM涨幅更大的情况。 |